



## 计算机

优于大市（维持）

### 证券分析师

陈涵泊

资格编号: S0120524040004

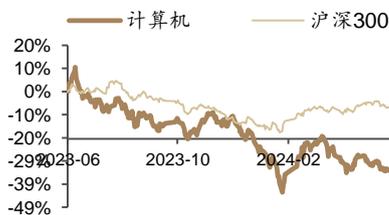
邮箱: chenhb3@tebon.com.cn

### 研究助理

王思

邮箱: wangsi@tebon.com.cn

### 市场表现



### 相关研究

- 《关注金融信创加速机会》，2024.6.6
- 《信创加速+高端趋势，国产打印机大有可为》，2024.6.4
- 《交通信息化招标启动，规模超预期》，2024.6.2
- 《电力 IT 系列 1：关于电改的 7 个趋势》，2024.5.29
- 《信创正站在新一轮拐点》，2024.5.19

# Computex2024: AI 硬件前奏响

## 投资要点:

- **高通: 骁龙 X 平台助力, PC 产业迎来重生。**高通骁龙 X Elite 平台是为了新时代而设计,也是全球最快、最有效率的具有 NPU 内核的 AI PC 芯片。高通 CEO 主题演讲有如下亮点:1)骁龙 X 系列处理器上的 Hexagon NPU 可提供高达 45TOPS 的性能,与竞争对手相比,骁龙 X Elite X1E-80-100 上的 NPU 据称分别比苹果 M3、Intel Core Ultra 7 155H 的每瓦性能高出 2.6、5.4 倍。2)宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、微软和三星等 OEM 合作伙伴,将在本月推出超过 22 款搭载骁龙 X Elite/Plus 处理器的 Copilot+ 品牌笔记本电脑,首批搭载骁龙 X Elite/Plus 的 Copilot+ PC 起价为 999 美元。3)骁龙 X 平台将不仅限于笔记本电脑,还将应用于其他个人计算平台,如一体机 (AIO)、迷你电脑、平板电脑和可转换笔记本电脑。
- **英伟达: 开启产业革命的全新时代。**1) GPU 启用“一年一代”技术路线,迭代速度粉碎摩尔定律。黄仁勋宣布 Blackwell 芯片现已开始投产,相比八年前的 Pascal 芯片,AI 算力提升了 1000 倍,用于训练 GPT-4 模型能耗下降了 350 倍。下一代 GPU Rubin 将于 2026 年发布,使用台积电 3nm 制程,集成 8 颗 HMB4。Rubin 平台具有新的 GPU、下一代 Vera CPU (ARM 架构)、NVLink 6 (3.6TB/秒)、CX9 SuperNIC(1.6TB/秒)、X1600 融合 InfiniBand/以太网交换机。2) 云原生 NIM 推理服务,加速 AI 应用开发部署。NIM 能将企业部署 AI 应用程序的时间,从几天压缩到几分钟。目前已有 40+ 个 NIM 微服务开放使用,全球 2800 万开发者都可以下载 NIM 到自己的数据中心,托管使用。3) 具身智能 Isaac 机器人平台夯实基础底座,生态系统迅速扩张。Isaac 平台具有一套英伟达加速库、AI 基础模型和模拟技术,西门子、比亚迪、Gideon 等都在与英伟达展开合作。4) 加码 AIPC 市场。黄仁勋表示,未来的 PC 将成为重要的 AI 平台,能够运行由 AI 增强的应用程序。根据芯智讯,现在全球有 1 亿台基于 GeForce RTX 的 AI PC,有超过 200 款搭载英伟达芯片的 RTX AI PC,华硕、微星等 PC 品牌厂商都是英伟达的合作伙伴。
- **AMD: 云侧紧追英伟达,端侧芯片性能领先。**1) 云端官宣年更 AI 加速芯片。AMD 董事长兼 CEO 苏姿丰表示今年将会推出全新的 AI 加速芯片 Instinct MI325X,2025 年推出 MI350,2026 年推出 MI400。MI325X 将延续 CDNA3 构架,采用第四代高带宽内存 HBM3E,容量大幅提升至 288GB,内存带宽也将提升至 6TB/s,整体的性能将进一步提升,AI 性能比 H200 提升 1.3 倍以上,将于今年 Q4 开始供货。2) 发布第三代 AI PC 芯片锐龙 AI 300 系列。NPU 采用全新的 XDNA2 架构,在 NPU 上首发引入 BF16 浮点精度,在精度、性能达到较好的平衡,芯片 NPU 性能赶超竞争对手。锐龙 AI 300 系列首发两款型号“锐龙 AI 9 HX 370”和“锐龙 AI 9 HX 365”定位高端,NPU 算力均高达 50TOPS,分别高于高通骁龙 X Elite、英特尔 Ultra Lunar Lake、苹果 M4 NPU 5、5、12TOPS。
- **英特尔: 瞄准 AI PC, 打造高效 SoC。**据量子位,公司推出新一代 AI PC 低功耗移动平台架构 Lunar Lake,采用全新 MoP 封装,片上集成 16 或 32GB 的 LPDDR5X 内存,无法再额外连接更多 RAM,这将使数据系统传统传输功耗降低约 40%。SoC 设计使其相比上一代处理器,AI 加速器规模增加 3 倍,性能提升超 4 倍,在相同的时钟速度下 CPU 性能提高 14%,图形性能提高了 50%,电池续航时间提高 60%。
- **投资建议。**建议关注: AI 芯片:海光信息、寒武纪、景嘉微、中国长城等; AI PC:联想集团、中科创达、虹软科技、星环科技、软通动力、云赛智联、云天励飞等。
- **风险提示:** PC 需求不及预期、AI 技术落地与应用不及预期、地缘政治冲突等。

# 信息披露

## 分析师与研究助理简介

**陈涵泊：**德邦证券计算机行业首席分析师，上海交通大学信息安全本科，电子与通信工程硕士，曾任职于中信证券研究部、天风证券研究所，多年计算机行业研究经验，具备成熟的计算机研究框架、自上而下产业前瞻视野，云计算领域深入研究。2022-2023年新财富最佳分析师入围（团队），2023年新浪金麒麟最佳分析师第五名（团队）。

**王思：**德邦证券计算机行业研究助理，湖南大学金融学学士，武汉大学金融学硕士，主要覆盖工业软件、云计算、网安等方向。

## 分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的6个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后6个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅；	类别	评级	说明
2. 市场基准指数的比较标准： A股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票投资评级	买入	相对强于市场表现20%以上；
		增持	相对强于市场表现5%~20%；
		中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
		减持	相对弱于市场表现5%以下。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平10%以下。

## 法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。